

2024.08.21 新闻发布

## 本公司参加东京工业大学WOW联盟， 成功开发晶圆对晶圆常温永久键合系统

艾美柯技术株式会社（AIMECHATEC, Ltd., 总部：日本茨城县龙崎市向阳台，社长：阿部猪佐雄），加入东京工业大学WOW联盟，成功开发了晶圆对晶圆常温永久键合系统。我们把该系统作为半导体事业的新提案，为尖端半导体封装量产工艺的的建立做出贡献。

该系统在Tech Extension Co., Ltd.,（东京工业大学的创业公司）承包的台湾下一代三维堆叠半导体生产线上，承担晶圆对晶圆永久键合工艺的生产，并将在2025年交付、用于即将投产的晶圆对晶圆制造工程。通过应用本公司在液晶面板制造技术中多年积累的高精度贴合技术，实现了常温下键合精度为100 nm以下的晶圆键合。

本公司正在扩大的晶圆处理系统的销售，该系统还包括对晶圆减薄和堆叠重要的晶圆临时键合和晶圆支撑件的剥离和清洁工艺。目前，在人工智能市场相关投资活跃的背景下，我们收到了很多订单和咨询。利用现有的晶圆处理系统和新开发的晶圆对晶圆常温永久键合系统，我们将进一步扩大包括 HBM 在内的存储器市场等的半导体事业。

本公司依旧本着通过制程工艺上的不断创新，以达到创造更方便更丰富的生活方式，为社会做出更多的贡献而努力。

### 相关信息

- 1) Tech Extension Co., Ltd. 2024.4.29 News Release  
[https://www.tech-extension.co.jp/doc/news\\_20240430\\_JP.pdf](https://www.tech-extension.co.jp/doc/news_20240430_JP.pdf)
- 2) Innolux 2024.4.29 News Release  
[https://www.innolux.com/en/media\\_center/news\\_list/news.html?p=2110](https://www.innolux.com/en/media_center/news_list/news.html?p=2110)

咨询：艾美柯技术株式会社  
营业部 TEL：0297-62-9119  
<https://www.ai-mech.com/>



晶圆永久键合单元（外观）